



Automatic electrolytic Ni-Au
plating equipment

LED 基板・フレキシブル基板 電解 Ni-Au めっき

～特徴～

当ラインでは、FPC・LED 基板を中心に生産しております。
その中でも薄物製品を得意としています。

～生産能力～

◎対応製品サイズ

電解 Ni-Au ライン : サイズ (MAX) 510×610mm 約 14,000 m²/Month

◎対応めっき仕様

電解 Ni めっき	0.50～15.0 μ m (硬質・軟質)
電解 Au めっき	0.03～0.50 μ m (硬質)
電解 Au めっき	0.03～0.50 μ m (軟質)
電解 Au めっき	0.06～0.10 μ m (ダイレクト軟質)

◆フリップチップ実装及び屈曲性を必要とする FPC に対応するダイレクト Au めっきも対応可能です。

◇ニッケル及び、金の組み合わせは自在です。硬質めっき・軟質めっきと選択することも出来ます。御社からのご要望に応じ提案・検討もさせていただきます。

【各ライン写真】

3号機 硬質・軟質・ダイレクト Au

5号機 硬質 Au

